

2027年3月期 第1四半期 決算説明資料

2026年8月6日

1

ハイライト

2

2026年度（2027年3月期） 第1四半期実績

3

2026年度（2027年3月期） 通期見通し

4

Appendix

ハイライト

ハイライト - 2026年度 1Q実績・2026年度 通期見通し

営業損益

2026年度 1Q実績

前年同期

296 億円

為替 145 円/USD
銅価 432 ¢/lb

当年実績

814 億円

為替 159 円/USD
銅価 604 ¢/lb

差異

+518 億円

為替 14 円/USD 円安
銅価 +172 ¢/lb

外部環境・一過性要因

- 環境要因(市況) +265億円
- 一過性要因 +190億円
(カセロネス一部権益売却益)

事業要因

- フォーカス事業増販 +80億円

2026年度 通期見通し

5月公表

1,900 億円

為替 150 円/USD
銅価 520 ¢/lb

8月公表

2,320 億円

為替 157 円/USD
銅価 586 ¢/lb

差異

+420 億円

為替 7 円/USD 円安
銅価 +66 ¢/lb

外部環境要因

- 環境要因(市況) +400億円
- チリ天候不良による鉱山減産
▲60億円

事業要因

- フォーカス事業増販 +30億円
- フォーカス事業販売単価改善
+25億円

業績推移

		2023年度実績	2024年度実績	2025年度実績
営業利益	連結	862 億円	1,125 億円	1,750 億円
	フォーカス事業	273 億円	518 億円	710 億円
営業利益率	フォーカス事業	9%	13%	14%

2026年度見通し

2,320 億円

1,000 億円

17%

全社、フォーカス事業ともに
着実な成長を見込む

ハイライト - 主な製品 販売数量 増減率

		2026年度 1Q実績 (2025年度 1Q実績 ▶ 2026年度 1Q実績)	2026年度 通期見通し (2025年度 通期実績 ▶ 2026年度 通期見通し)
			5月公表8月公表
半導体材料	薄膜材料		
	半導体用ターゲット	+ 26%	+ 19% ⇩ + 21%
	磁性材ターゲット	+ 8%	+ 7% ⇩ + 8%
	インジウムリン InP基板	+ 8%	+ 13% ⇨ + 13%
情報通信材料	TaNb*		
	キャパシタ向けタンタル粉末	+ 89%	+ 16% ⇩ + 2%
			AIデータセンター +62% その他 +9%
			AIデータセンター +62% その他 ▲9%
機能材料	圧延銅箔	+ 3%	+ 5% ⇨ + 5%
	チタン銅	+ 42%	+ 32% ⇩ + 33%

AIデータセンター関連の需要
拡大を取り込み、引き続き
堅調に推移

順調に進捗中
半導体用ターゲット、磁性材
ターゲットは上方修正
InP基板は、既存設備に
おける生産効率改善を
継続中

引き続き堅調なAIデータセン
ター関連需要を取り込み
販売単価改善と高収益品
へのポートフォリオ転換により、
収益性改善を図る

高水準の前年同期実績を
上回る販売

順調に進捗中
チタン銅は上方修正

ハイライト – 生産能力増強計画

半導体材料

✓ AIデータセンター関連を中心とした需要拡大に対応するため、積極的に生産能力増強を推進

	地域	増産規模（生産能力）	稼働時期
 半導体用ターゲット	日本 (ひたちなか工場)	(2025年度比) 1.3倍 上記に対応するため、 最終工程 現地加工能力 1.4倍 （台湾）、 2倍 （韓国）	2027年度から順次
 磁性材ターゲット	日本 (磯原工場)	(2025年度比) 1.2倍	2026年度下期
 インジウムリン InP基板	日本 (磯原・ひたちなか工場)	(2025年度比) 7～10倍	2026年度下期から順次
 タンタル粉末	タイ	(2025年度比) 1.5倍	2027年前半から順次

➤ 急速な需要拡大が見込まれる製品(チタン銅等)については、必要に応じ、さらなる生産能力増強を検討

ハイライト – 東邦チタニウム

情報通信材料

 **東邦チタニウム株式会社** ✓ 株式交換により、2026年6月より100%子会社化

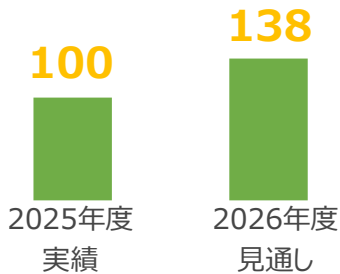
主な事業	主な製品	用途例	足元の状況・今後の方向性
チタン事業	スポンジチタン		航空機エンジン部品、機体材料
	高純度チタン		スパッタリングターゲット
化学品事業	超微粉Ni		積層セラミックコンデンサ（MLCC） 旺盛な需要を受け、供給能力・生産体制強化を検討中。AIデータセンター向け需要取り込みに向け、JX金属との市場情報共有によるマーケティング・製品開発を促進中
触媒事業	THC触媒		自動車内外装や家電製品等向けのポリプロピレン、ポリオレフィン JX金属のネットワーク活用による拡販に向けた市場分析や顧客開拓の動きを強化中
新素材事業	CVD/ALDプリカーサー材料		半導体薄膜形成材料 今後の需要増を見据え生産体制の強化やプリカーサーのラインナップ拡充を検討中

AIサーバ向けMLCC 市場成長率

20-40%
(CAGR 2025~2035年)
※当社推定

超微粉Ni 販売量

(指数：2025年度 = 100)



当社製品の伸長に加え、MLCC市場の成長を背景に、今後も堅調な成長を見込む

既存公表分（2023年2月リリース）の能力増強は今期に稼働開始済み。

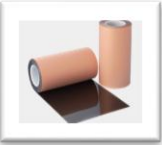
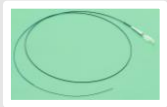
マーケティング強化による拡販や、さらなる増強も検討中

ハイライト – タツタ電線

情報通信材料

TATSUTA タツタ電線株式会社

✓ 公開買付および株式併合により、2024年11月より100%子会社化

主な事業	主な製品	用途例	足元の状況・今後の方向性
ワイヤー & ケーブル事業	インフラ・産業機器向け電線・ケーブル	 インフラ（発電所・配電設備・建販等）向け、産業機器（FA・ロボット・工作機械等）向けの電線・ケーブル	価格戦略の推進により増収を実現 原料ソースの多様化やリサイクル原料の調達拡大、リサイクル銅を活用した差別化を促進
電子材料事業	電磁波シールドフィルム	 電磁波ノイズによるスマートフォン等電子機器の誤作動防止用フィルム	スマートフォン市場の情報共有によるクロスチャネル構築、既存製品の性能改善や新製品開発を加速
センサー & メディカル事業	漏水センサ	 AIサーバ・データセンタ向け漏水センサ	急激な需要増を踏まえ、能力増強を決定 さらなる能力増強およびJX金属の拠点・販路活用を検討中
	各種医療機器用部材・製品	 マイクロカテーテル、心電図電極用カーボンリード線等	製品開発等におけるコラボレーションを推進

AIサーバ出荷台数 成長率

29.6%
(CAGR 2025~2030年)
(出所) Prismark Partners LLC

AIサーバ関連需要の拡大を受け、能力増強（2025年度比3割増）を決定（2026年8月リリース）
更なる需要増を見据え追加増強を検討

2026年度（2027年3月期） 第1四半期実績

連結損益計算書

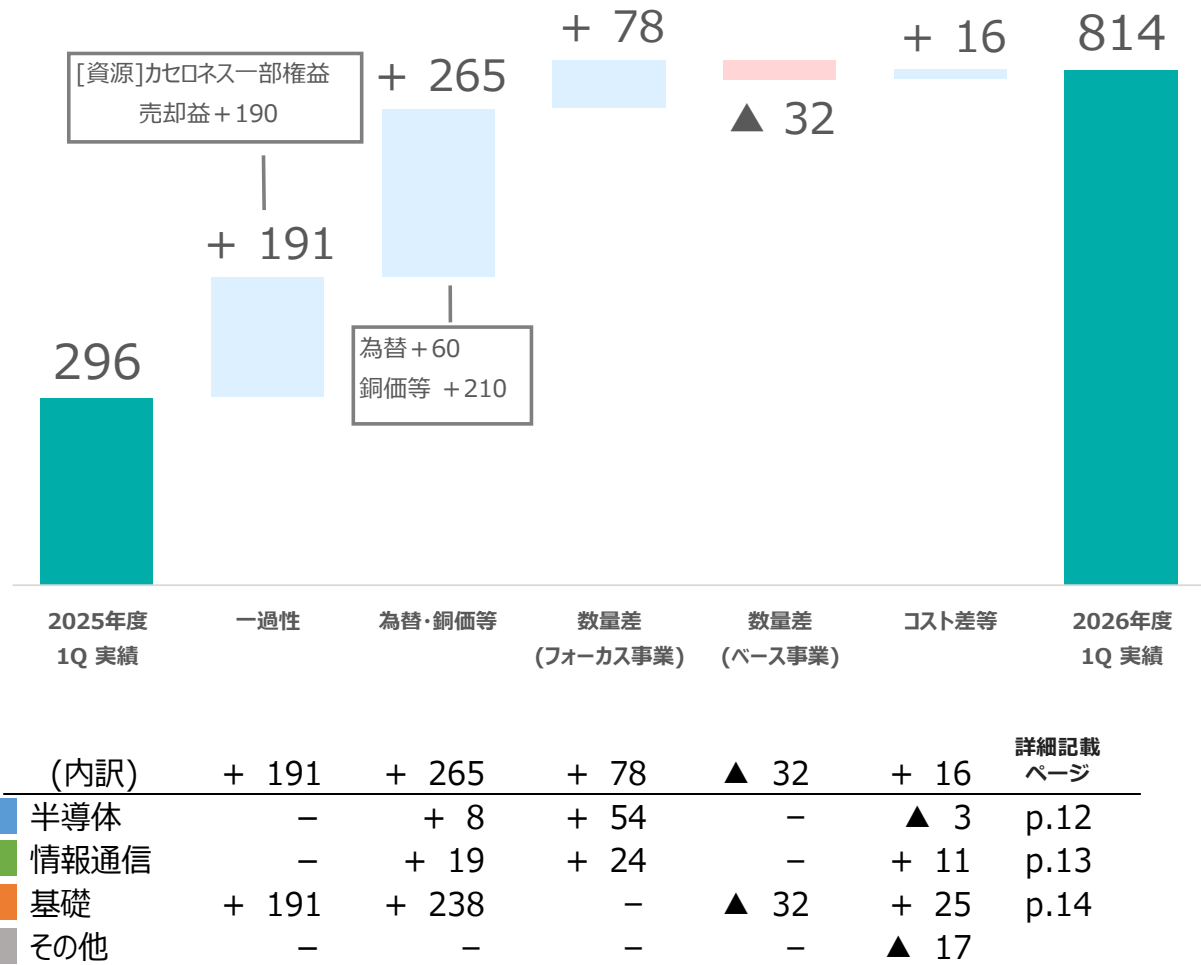
		2025年度	2026年度	前年同期比	
(億円)		1Q実績	1Q実績	差異	増減率
売上高		1,913	2,606	+ 693	+36%
(フォーカス事業)		1,170	1,452	+ 282	+24%
(ベース事業)		750	1,237	+ 487	+65%
(その他)		▲ 7	▲ 83	▲ 76	-
営業損益		296	814	+ 518	+175%
(フォーカス事業)		162	275	+ 113	+70%
(ベース事業)		146	568	+ 422	+289%
(その他)		▲ 12	▲ 29	▲ 17	-
税引前利益		285	796	+ 511	+179%
当期利益		232	604	+ 372	+160%
親会社の所有者に 帰属する当期利益		189	531	+ 342	+181%
為替(円/USD)		145	159	+ 14	+10%
LME銅価(¢/lb)	平均	432	604	+ 172	+40%
	前期末/当期末	439/455	552/605		

事業セグメント別 売上高及び営業損益

			2025年度	2026年度	前年同期比	
(億円)			1Q実績	1Q実績	差異	増減率
フォーカス事業	半導体材料	売上高	388	521	+ 133	+34%
		営業損益	85	144	+ 59	+69%
	情報通信材料	売上高	782	931	+ 149	+19%
		営業損益	77	131	+ 54	+70%
ベース事業	基礎材料	売上高	750	1,237	+ 487	+65%
		営業損益	146	568	+ 422	+289%
その他	事業共通費用等	売上高	▲ 7	▲ 83	▲ 76	-
		営業損益	▲ 12	▲ 29	▲ 17	-
合計		売上高	1,913	2,606	+ 693	+36%
		営業損益	296	814	+ 518	+175%

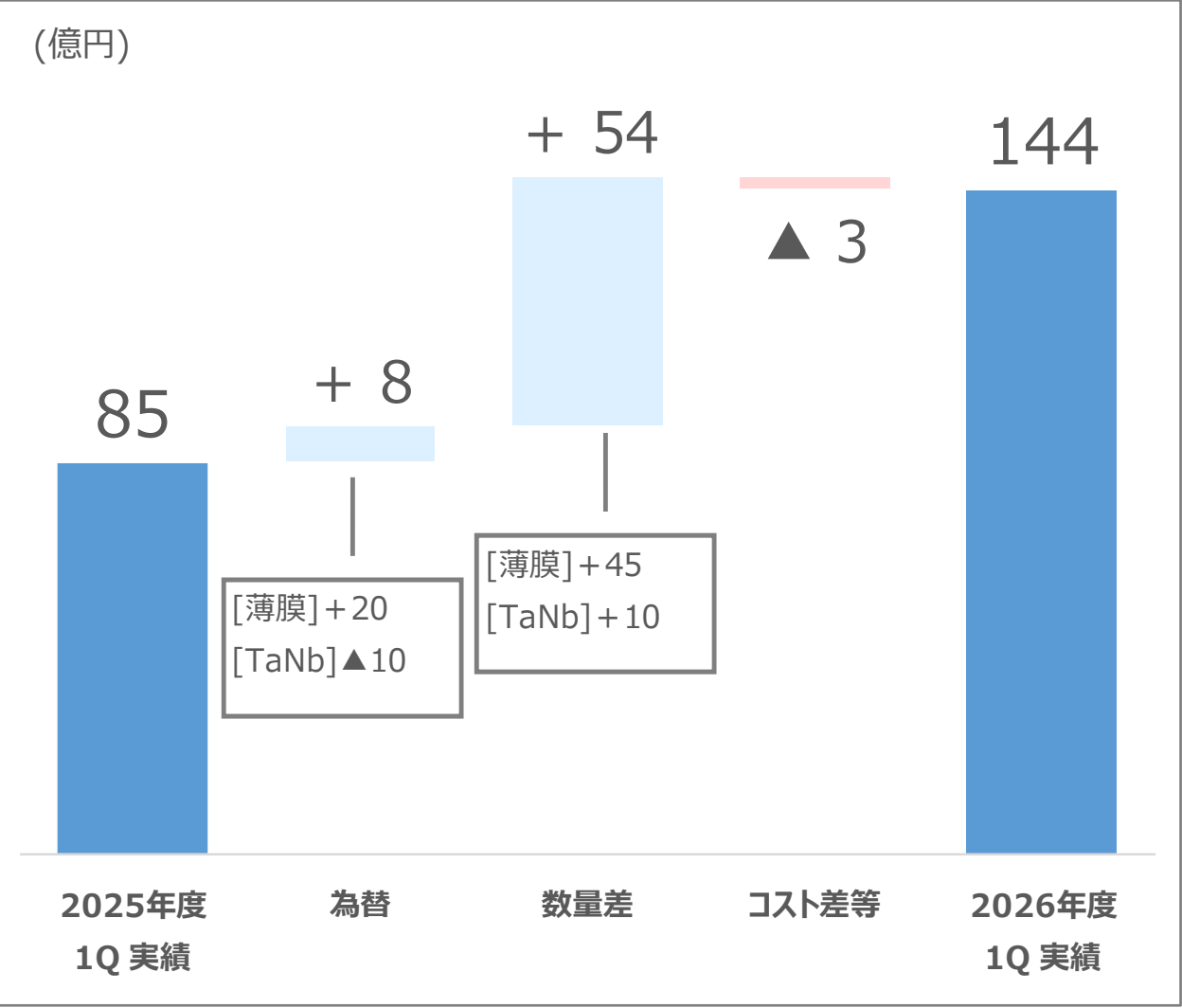
営業損益差異

(億円)



営業損益差異分析 半導体材料セグメント[2026年度1Q実績 対 2025年度1Q実績]

営業損益差異分析



事業別概況

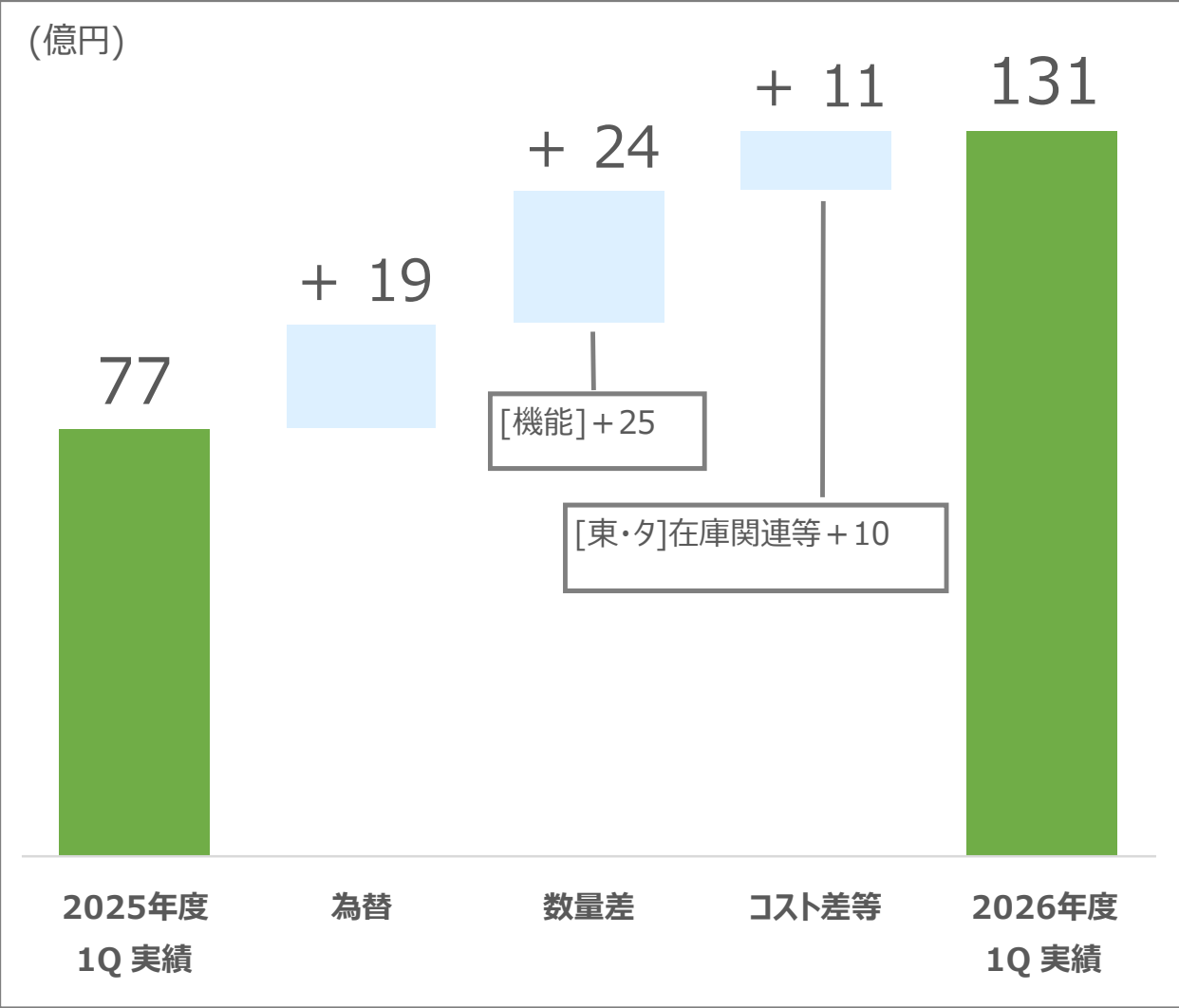
- 薄膜材料**
 - AIデータセンター関連需要の拡大を受けた主力製品の増販継続により増益
- タンタル・ニオブ (TaNb)**
 - キャパシタ向けタンタル粉末増販も、為替影響（ユーロ高）等により減益

事業別 売上高・営業損益

	億円	2025年度	2026年度	前年同期比	
		1Q実績	1Q実績	差異	増減率
薄膜材料	売上高	325	456	+ 131	+40%
	営業損益	84	153	+ 69	+82%
タンタル・ニオブ (TaNb)	売上高	100	108	+ 8	+8%
	営業損益	3	▲ 11	▲ 14	-
調整等	売上高	▲ 37	▲ 43	▲ 6	-
	営業損益	▲ 2	2	+ 4	-
セグメント合計	売上高	388	521	+ 133	+34%
	営業損益	85	144	+ 59	+69%

営業損益差異分析 情報通信材料セグメント[2026年度1Q実績 対 2025年度1Q実績]

営業損益差異分析



事業別概況

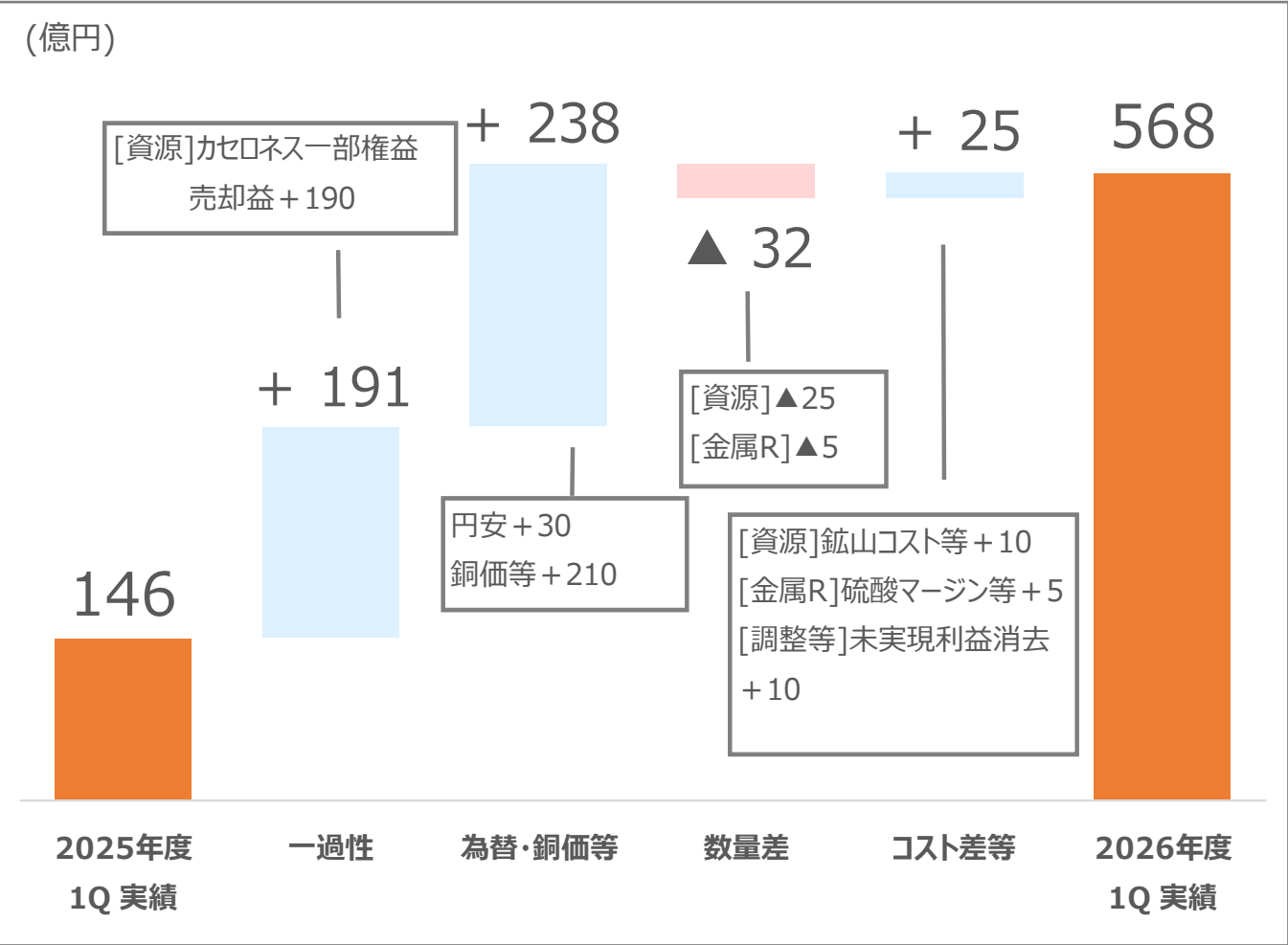
- 機能材料**
 - 堅調なスマートフォン関連の需要や、AIデータセンター関連の需要拡大を背景とした増販により増益
- 東邦チタニウム、タツタ電線等**
 - 為替円安影響等により増益

事業別 売上高・営業損益

	億円	2025年度	2026年度	前年同期比	
		1Q実績	1Q実績	差異	増減率
機能材料	売上高	378	493	+ 115	+30%
	営業損益	57	89	+ 32	+56%
東邦チタニウム、 タツタ電線等	売上高	404	438	+ 34	+8%
	営業損益	20	42	+ 22	+110%
セグメント合計	売上高	782	931	+ 149	+19%
	営業損益	77	131	+ 54	+70%

営業損益差異分析 基礎材料セグメント[2026年度1Q実績 対 2025年度1Q実績]

営業損益差異分析



事業別概況

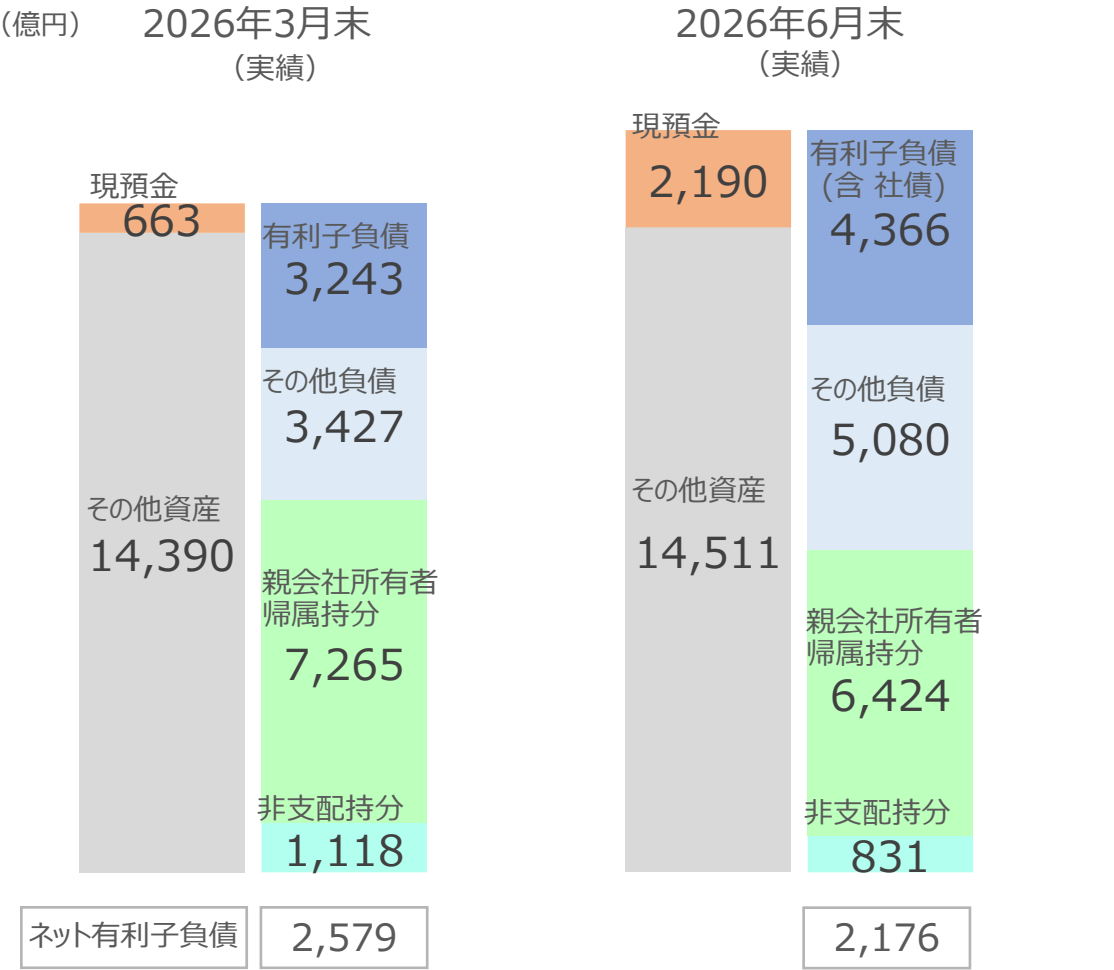
- 資源**
 - カセロネス権益一部譲渡に伴う売却益、為替円安・銅価等の上昇を主因に増益
- 金属・リサイクル (金属R)**
 - 為替円安、銅価等の上昇、硫酸マージン改善等により増益

事業別 売上高・営業損益

	億円	2025年度	2026年度	前年同期比	
		1Q実績	1Q実績	差異	増減率
資源	売上高	8	12	+ 4	+50%
	営業損益	115	472	+ 357	+310%
金属・リサイクル (金属R)	売上高	742	1,227	+ 485	+65%
	営業損益	35	91	+ 56	+160%
調整等	売上高	—	▲ 2	▲ 2	—
	営業損益	▲ 4	5	+ 9	—
セグメント合計	売上高	750	1,237	+ 487	+65%
	営業損益	146	568	+ 422	+289%

連結バランスシート・キャッシュフロー/投融資・減価償却費・研究開発費

■ 連結バランスシート



自己株式TOBに充当予定のCB調達資金が、当四半期末時点では手元資金として残存したことにより、ネット有利子負債は一時的に減少

■ 連結キャッシュフロー

(億円)	2026年度 1Q実績
営業キャッシュフロー	132
投資キャッシュフロー	79
フリーキャッシュフロー	211
財務キャッシュフロー	1,309
現金同等物の増減額	1,520
為替変動による影響等	7

■ 投融資・減価償却費・研究開発費

(億円)	2024年度 実績	2025年度 実績	2026年度 1Q実績
投融資	923	845	256
減価償却費	440	447	126
研究開発費	178	200	53

2026年度（2027年3月期） 通期見通し

連結損益計算書

(億円)	2026年度	2026年度	前回比	
	5月公表	8月公表	差異	増減率
売上高	9,300	10,250	+ 950	+10%
(フォーカス事業)	5,300	5,850	+ 550	+10%
(ベース事業)	4,200	4,700	+ 500	+12%
(その他)	▲ 200	▲ 300	▲ 100	-
営業損益	1,900	2,320	+ 420	+22%
(フォーカス事業)	820	1,000	+ 180	+22%
(ベース事業)	1,240	1,470	+ 230	+19%
(その他)	▲ 160	▲ 150	+ 10	-
税引前利益	1,780	2,210	+ 430	+24%
当期利益	1,400	1,740	+ 340	+24%
親会社の所有者に 帰属する当期利益	1,140	1,410	+ 270	+24%
為替(円/USD)	150	157	+ 7	+5%
LME銅価(¢/lb)	平均 520	586	+ 66	+13%
	前期末/当期末 552/520	552/580		

為替・LME銅価前提

	7月～9月	10月～3月
為替(円/USD)	160	155
LME銅価(¢ /lb)	580	

営業利益感応度 (2026年7月以降)

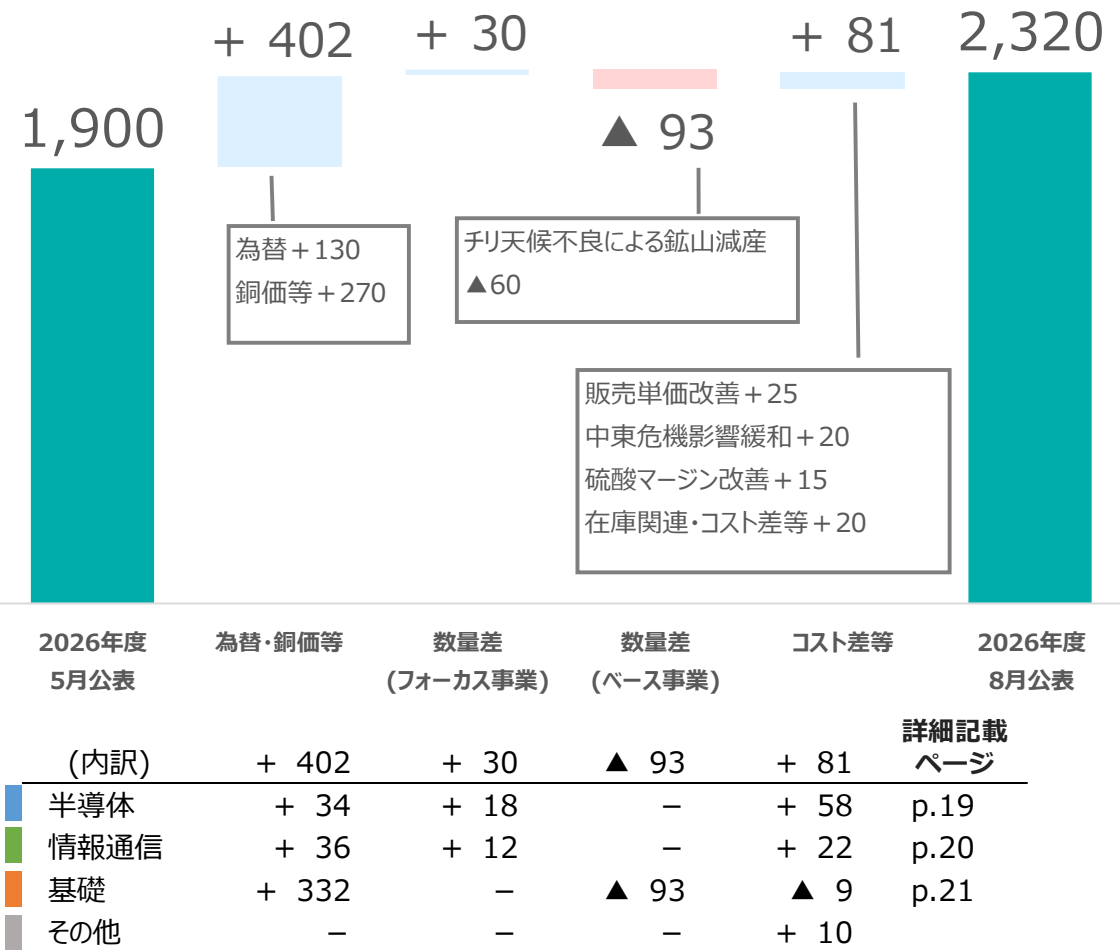
単位：億円	為替 5円円安	銅価 + 10¢/lb
フォーカス事業	+ 35	—
ベース事業	+ 35	+ 35
合計	+ 70	+ 35

事業セグメント別 売上高及び営業損益

			2026年度	2026年度	前回比	
(億円)			5月公表	8月公表	差異	増減率
フォーカス事業	半導体材料	売上高	2,000	2,300	+ 300	+15%
		営業損益	500	610	+ 110	+22%
	情報通信材料	売上高	3,300	3,550	+ 250	+8%
		営業損益	320	390	+ 70	+22%
ベース事業	基礎材料	売上高	4,200	4,700	+ 500	+12%
		営業損益	1,240	1,470	+ 230	+19%
その他	事業共通費用等	売上高	▲ 200	▲ 300	▲ 100	-
		営業損益	▲ 160	▲ 150	+ 10	-
合計		売上高	9,300	10,250	+ 950	+10%
		営業損益	1,900	2,320	+ 420	+22%

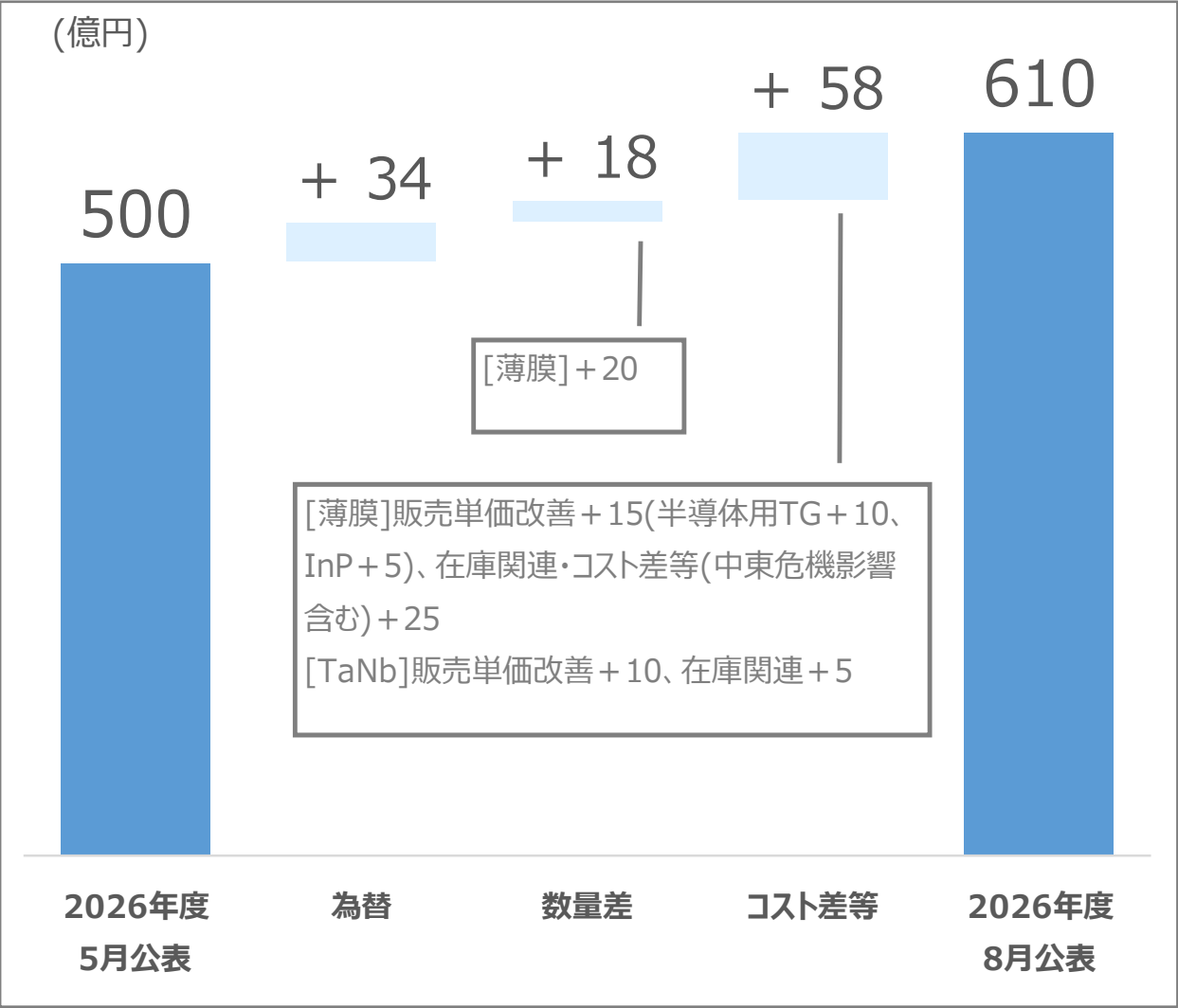
営業損益差異

(億円)



営業損益差異分析 半導体材料セグメント[2026年度見通し 8月公表 対 5月公表]

営業損益差異分析



事業別概況

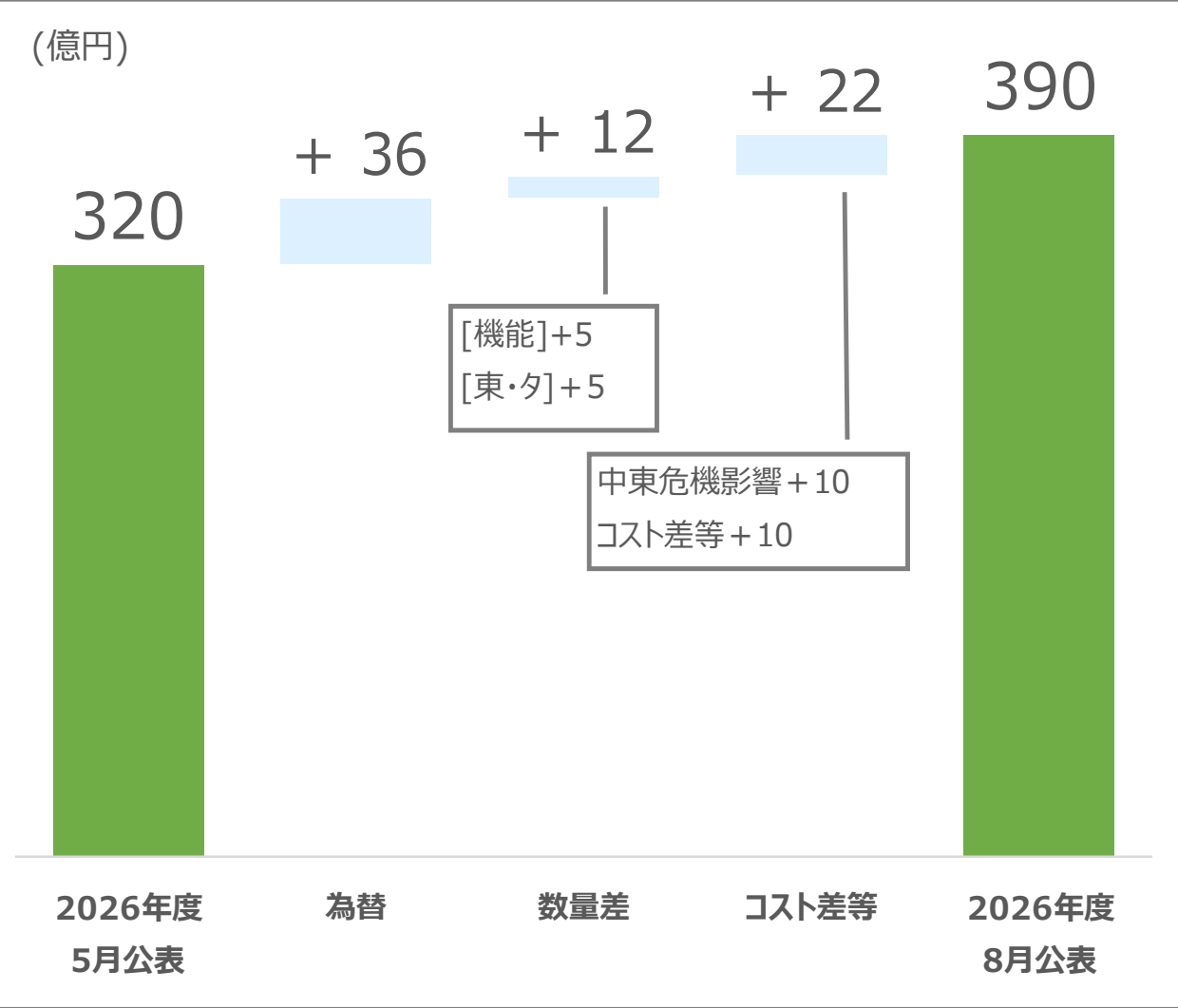
- 薄膜材料**
 - AIデータセンター関連の需要拡大を受けた増販および半導体用ターゲット、InP基板の販売単価改善、為替円安を主因に増益
- タンタル・ニオブ (TaNb)**
 - キャパシタ向けタンタル粉末の低収益品減販も、販売単価改善等により増益

事業別 売上高・営業損益

	億円	2026年度	2026年度	前年同期比	
		5月公表	8月公表	差異	増減率
薄膜材料	売上高	1,700	1,900	+ 200	+12%
	営業損益	490	580	+ 90	+18%
タンタル・ニオブ (TaNb)	売上高	500	550	+ 50	+10%
	営業損益	10	30	+ 20	+200%
調整等	売上高	▲ 200	▲ 150	+ 50	-
	営業損益	-	-	-	-
セグメント合計	売上高	2,000	2,300	+ 300	+15%
	営業損益	500	610	+ 110	+22%

営業損益差異分析 情報通信材料セグメント[2026年度見通し 8月公表 対 5月公表]

営業損益差異分析



事業別概況

機能材料
東邦チタニウム
タツタ電線

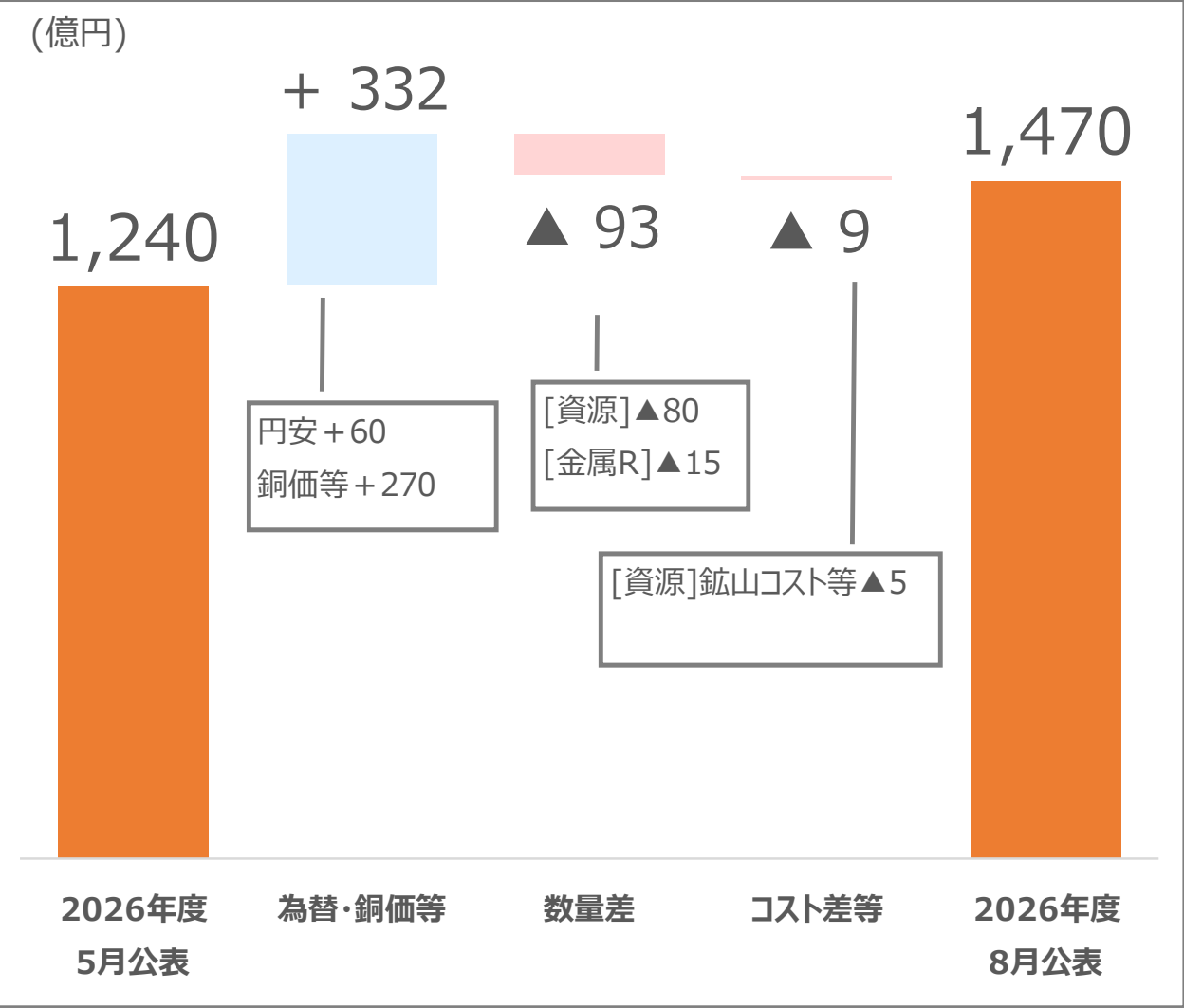
- 為替円安や中東危機影響緩和を主因に増益

事業別 売上高・営業損益

	億円	2026年度	2026年度	前年同期比	
		5月公表	8月公表	差異	増減率
機能材料	売上高	1,600	1,800	+ 200	+13%
	営業損益	230	260	+ 30	+13%
東邦チタニウム、 タツタ電線等	売上高	1,700	1,750	+ 50	+3%
	営業損益	90	130	+ 40	+44%
セグメント合計	売上高	3,300	3,550	+ 250	+8%
	営業損益	320	390	+ 70	+22%

営業損益差異分析 基礎材料セグメント[2026年度見通し 8月公表 対 5月公表]

営業損益差異分析



事業別概況

資源

- チリ天候不良による鉱山における減産はあるものの、為替円安・銅価前提上方修正を主因に増益

金属・リサイクル (金属R)

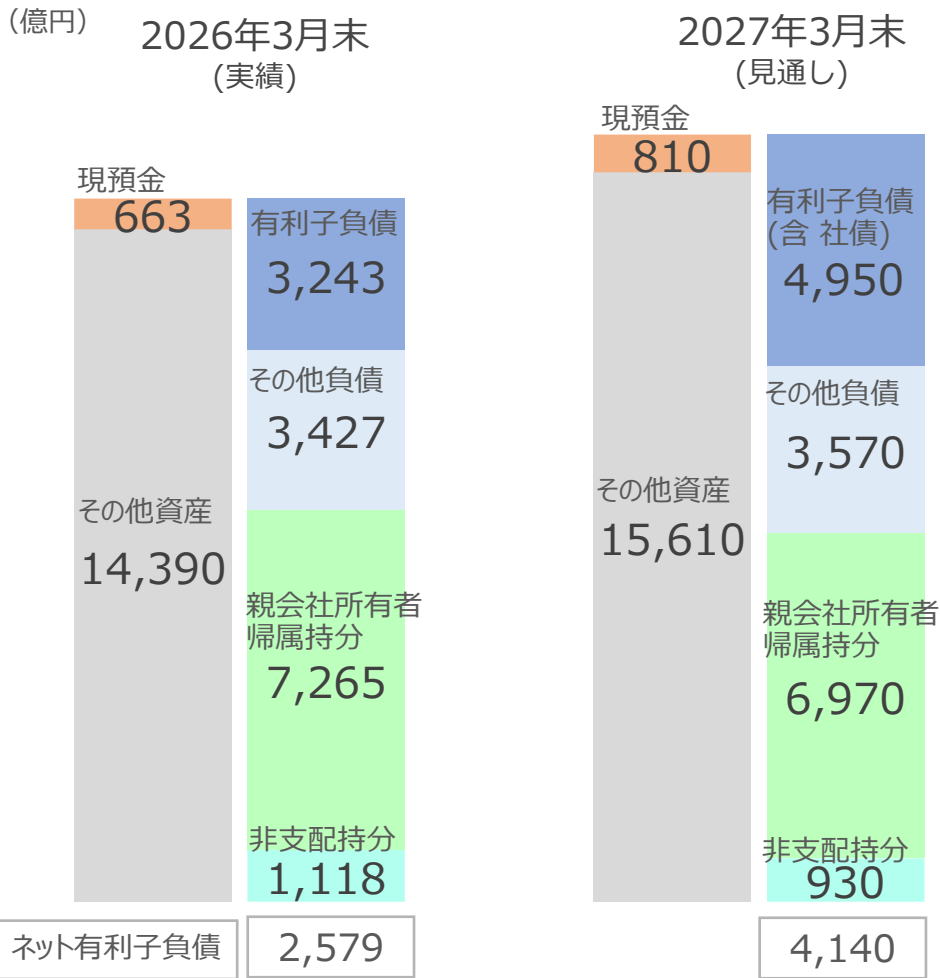
- 為替円安・銅価前提上方修正を主因に増益

事業別 売上高・営業損益

	億円	2026年度	2026年度	前年同期比	
		5月公表	8月公表	差異	増減率
資源	売上高	100	50	▲ 50	-
	営業損益	970	1,180	+ 210	+22%
金属・リサイクル (金属R)	売上高	4,100	4,650	+ 550	+13%
	営業損益	270	290	+ 20	+7%
調整等	売上高	-	-	-	-
	営業損益	-	-	-	-
セグメント合計	売上高	4,200	4,700	+ 500	+12%
	営業損益	1,240	1,470	+ 230	+19%

2026年度見通し 連結バランスシート・キャッシュフロー/株主還元

■ 連結バランスシート



主にCBの発行による有利子負債の増加となる見込み。他方、自己株式の取得による自己資本の減少を通じた資本効率改善を見込む

■ 連結キャッシュフロー

(億円)

	2026年度見通し
営業キャッシュフロー	1,350
投資キャッシュフロー	▲ 950
フリーキャッシュフロー	400
財務キャッシュフロー	▲ 240
現金同等物の増減額	160
為替変動による影響等	▲ 10

■ 投融資

(億円)

5月公表	8月公表
1,140	1,350

生産能力増強投資を反映

■ 株主還元

配当方針 (再掲)

連結配当性向25%程度を基本とした上で、配当の下限を20円/株とする。但し、大規模な資産売却や自己株式の取得を行う場合は総還元性向も考慮して別途検討する。また、2027年3月期の株主還元方針については多額の自己株式の取得を行うため、配当は下限の20円/株とする。

	2027年3月期	
1株あたり配当金	予定	
	20円	
	中間 10円	期末 10円
配当性向	13%	

(参考：2027年3月期の総還元性向は約151%)
※自己株式取得額 1,949億円

Appendix

- トピックス（2026年度）
- 会社概要
- 長期ビジョン・沿革
- 主な製品一覧
- 当社データセンター関連製品
- 半導体用ターゲットについて
- グローバルトップシェアを実現する当社半導体用ターゲットの強み
- InP基板について
- ベース事業の取り組み
- 中長期事業目標

トピックス（2026年度）

■ 半導体材料 ■ 情報通信材料 ■ 基礎材料

- 5月 銅精鉱の購入・電気銅等の販売に係る事業の統合に関する最終契約書の締結
- 6月 台湾日鉱金属における半導体用スパッタリングターゲット加工ラインの自動化投資の決定
- 6月 TANIOBIS社タイ国内生産拠点での機能性タンタル粉末の生産能力増強
- 6月 ハードディスクメディア向け磁性材スパッタリングターゲット生産能力増強
- 6月 インジウムリン(InP)基板の大幅な生産能力増強に向けた設備投資方針の決定
- 6月 半導体検査プローブカード向け材料(ロジウムめっき液)の生産能力増強の決定
- 7月 韓国JX金属における半導体用スパッタリングターゲットの加工能力増強の決定
- 8月 AIデータセンター内で使用される漏水検知システムの生産能力増強(タツタ電線)

会社概要

半導体・情報通信分野に欠かせない先端素材をマーケットに供給するグローバルトップメーカー
事業・主力製品

フォーカス事業

ベース事業

高度な技術的差別化の実現により、グローバル競争優位性を持つ当社成長戦略のコア事業 ★AIサーバ関連

薄膜材料

半導体用ターゲット ★



#1
約65%¹

半導体ウエハにナノレベルの膜を形成するために必要な金属材料

カドミウム・ジंक・テルル
CdZnTe基板



放射線・赤外線センサ素子に使用される単結晶基板

磁性材ターゲット ★



大容量ハードディスクドライブに膜を形成するために必要な金属材料

CVD⁴/ALD⁵プリカーサ材料



CVD/ALDによる薄膜形成に使用される金属原料

インジウムリン
InP基板 ★



光通信の受発光素子材料

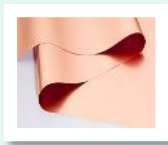
タンタル・ニオブ
タンタル粉末 ★



半導体用ターゲットやキャパシタに使用される金属粉末

機能材料

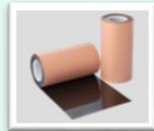
圧延銅箔



#1
78%²

FPC（フレキシブルプリント基板）³に用いられる屈曲性に優れた金属箔

タツタ電線
電磁波シールドフィルム



強度・導電性・曲げ加工性に優れた合金材料

モバイル機器の回路を電磁波ノイズから保護する機能性フィルム

最終用途例

AIサーバ



ウェアラブル



スマートフォン



モビリティ（xEV/ADAS）



銅、レアメタル（タンタル、チタンなど）のサプライチェーン強化を通じて、フォーカス事業の成長を支える

注1：当社推定；注2：富士キメラ総研「2024 エレクトロニクス実装ニューマテリアル便覧」（2023年実績、FPC向けのみ、出荷数量ベース）；注3：FPC(Flexible Printed Circuits)：絶縁性を持ったベースフィルムと銅箔等の導電性金属を貼り合わせた基材に電気回路を形成した基板；注4：Chemical Vapor Deposition；注5：Atomic Layer Deposition

長期ビジョン・沿革

●長期ビジョン策定

● 基本方針

「装置産業型企业」から「技術立脚型企业」への転身により、
激化する国際競争の中にあっても高収益体質を実現、
半導体材料／情報通信材料のグローバルリーダーとして、
持続可能な社会の実現に貢献する

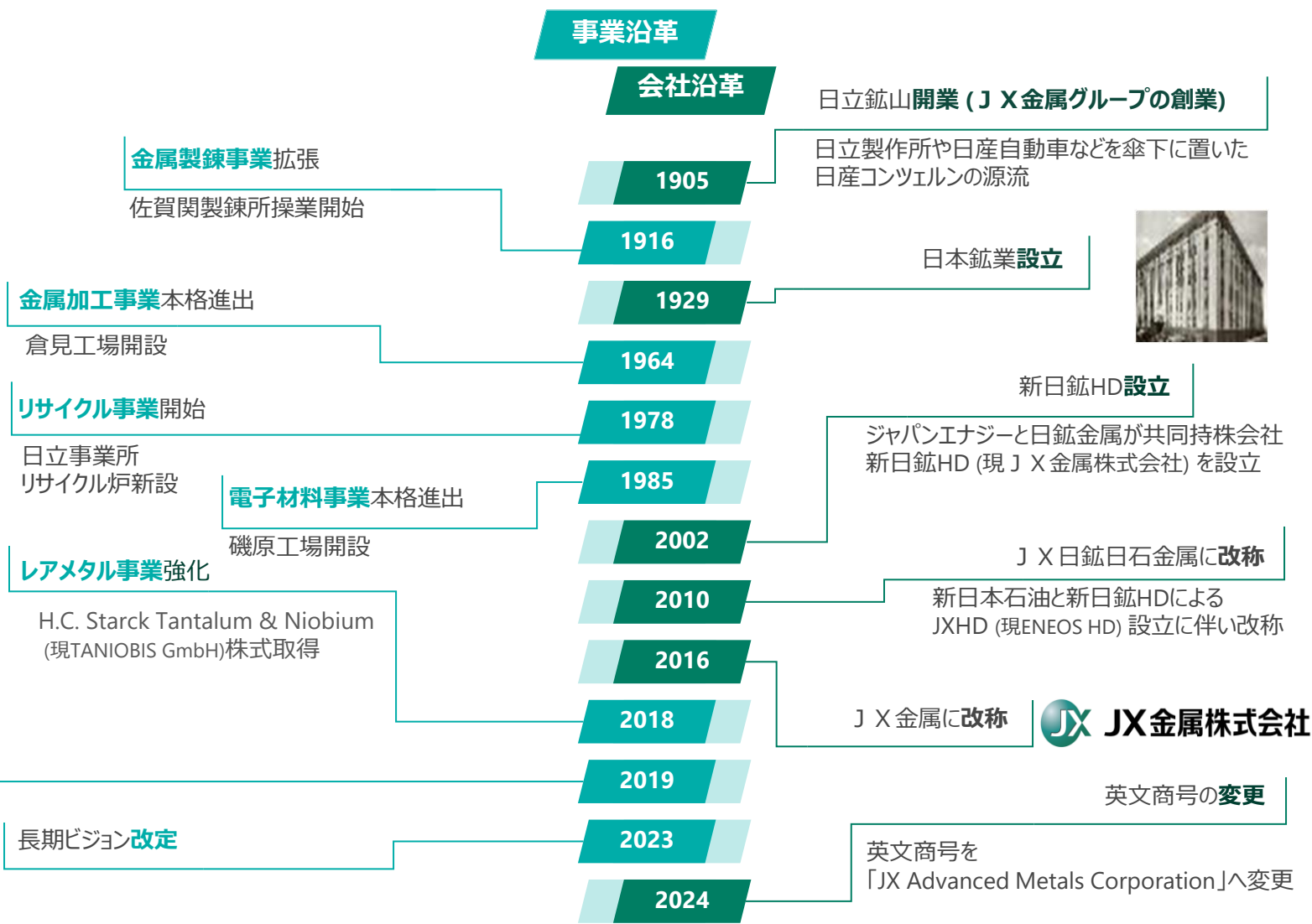
● 目指すポートフォリオ

【成長】フォーカス事業

- 成長戦略のコアとして位置づけ
- 技術による差別化によりグローバル競争で優位に立ち、市場成長以上の利益成長を図る

【基盤】ベース事業

- サプライチェーン強化を通じてフォーカス事業の成長を支える
- 半導体材料／情報通信材料に不可欠な銅及びレアメタルを中心ドメインと位置付ける



主な製品一覧

主な製品（写真）

半導体材料


半導体用ターゲット


InP基板


CVD・ALD材料

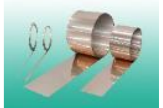

磁性材ターゲット


CdZnTe基板


タンタル粉

情報通信材料


圧延銅箔

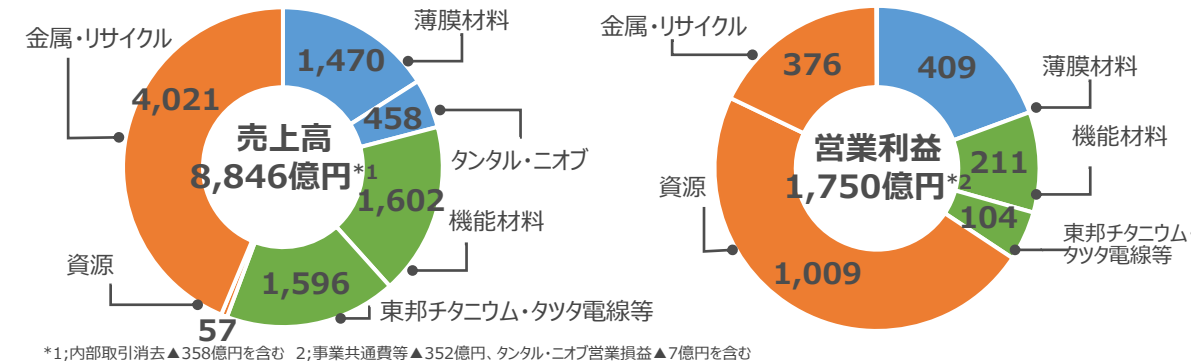

チタン銅

基礎材料


銅精鉱（銅鉱山）

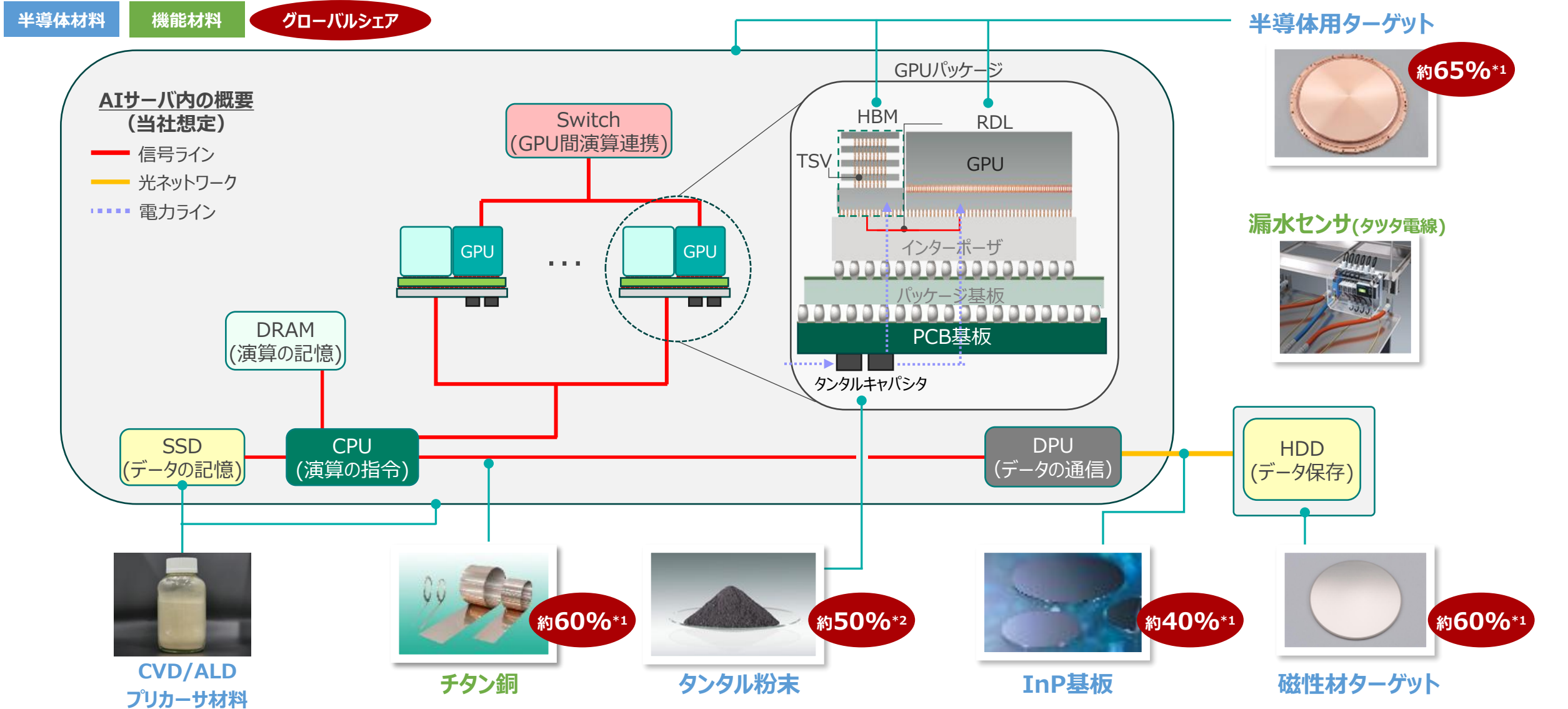

電気銅

サブセグメント別 売上高/営業損益（2025年度）



(2026年8月時点)		セグメント	サブセグメント	主な製品	主要用途	最終用途例
フォーカス事業	半導体材料	薄膜 ^(はくまく) 材料	半導体用ターゲット 磁性材ターゲット インジウムリン（InP）基板 カドミウム・ジンク・テルル（CdZnTe）基板 CVD・ALD用材料	半導体用ターゲット	半導体ウエハ上の金属薄膜形成	半導体（データセンター、PC、スマートフォン）
				磁性材ターゲット	磁気記録メディア上の金属薄膜形成	HDD（データセンター）、磁気センサ
				インジウムリン（InP）基板	光⇄電気の変換（受発光素子）	光通信（データセンター）
				カドミウム・ジンク・テルル（CdZnTe）基板	赤外線検知、放射線検知	防衛システム、CTスキャン
				CVD・ALD用材料	半導体用配線材料	半導体（データセンター、PC、スマートフォン）
				タンタル・ニオブ	スパッタリングターゲット向けタンタル粉末 キャパシタ向けタンタル粉末	半導体（データセンター、PC、スマートフォン） タンタルキャパシタ（データセンター、PC）
	情報通信材料	機能材料	圧延銅箔 チタン銅 東邦チタニウム・タツタ電線	圧延銅箔	FPC（フレキシブルプリント基板）用材料	スマートフォン、ウェアラブル、ロボット、医療用カテーテル
				チタン銅	コネクタ用材料、カメラばね用材料	サーバ向けコネクタ（データセンター）、カメラモジュール
				(東邦チタ) スポンジチタン	航空機エンジン部品、機体材料	航空機、化学・電力プラント
				化学品（超微粉ニッケル）	積層セラミックコンデンサ（MLCC）内部電極向け材料	積層セラミックコンデンサ
ベース事業	基礎材料	資源	銅精鉱・電気銅・モリブデン精鉱 （持分比率）カセロネス銅鉱山：25% ロス・ペランプレス銅鉱山：12.52% エスコンディーダ銅鉱山：3%	THC触媒	ポリプロピレン、ポリオレフィン製造用触媒	自動車内外装、家電製品、包装材
				(タツタ) インフラ・産業機器用電線	電線向け材料	発電所・プラント向け電線・ケーブル
				電磁波シールドフィルム	電子モバイル機器の内部回路保護	スマートフォン
		金属・リサイクル	銅精鉱・電気銅・モリブデン精鉱 （持分比率）カセロネス銅鉱山：25% ロス・ペランプレス銅鉱山：12.52% エスコンディーダ銅鉱山：3%	電気銅、型銅、貴金属、硫酸	-	-
				（持分比率）パンパシフィック・銅パー：47.8%	-	-

当社データセンター関連製品



*1 : 当社推定 *2 : 当社推定。スパッタリングターゲット向け含む

半導体用ターゲットについて

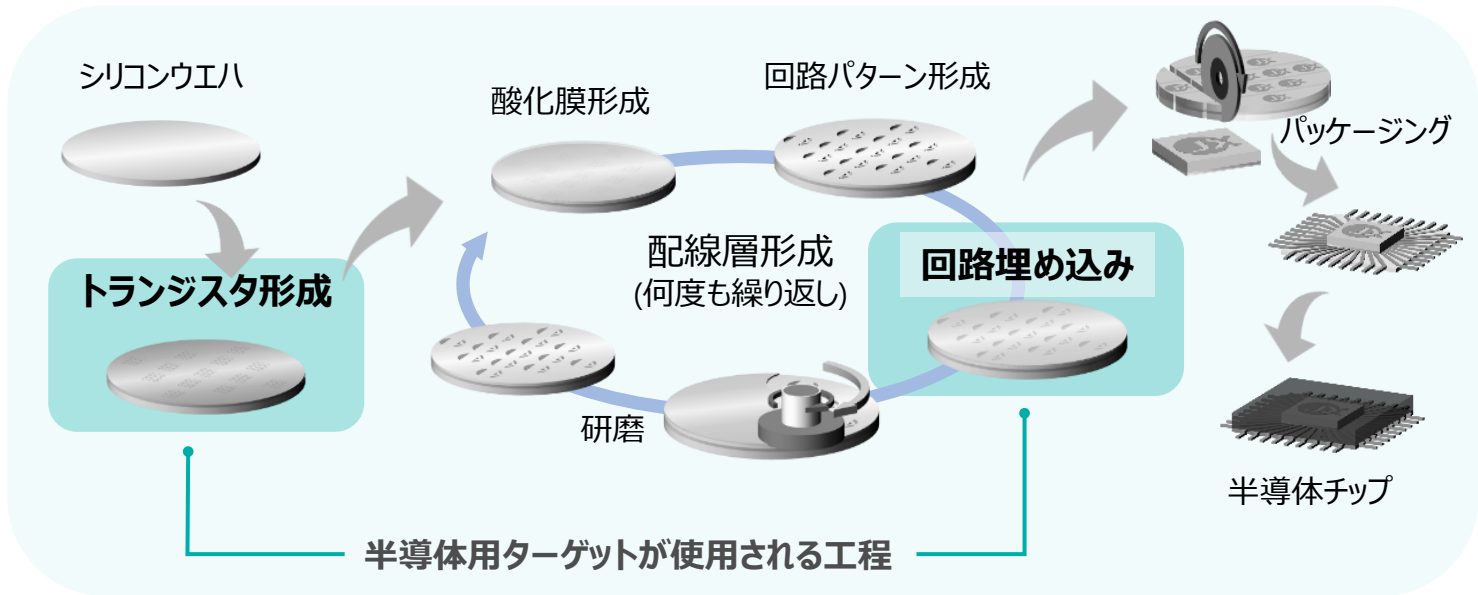
半導体用ターゲットとは



No.1
世界シェア
約6割

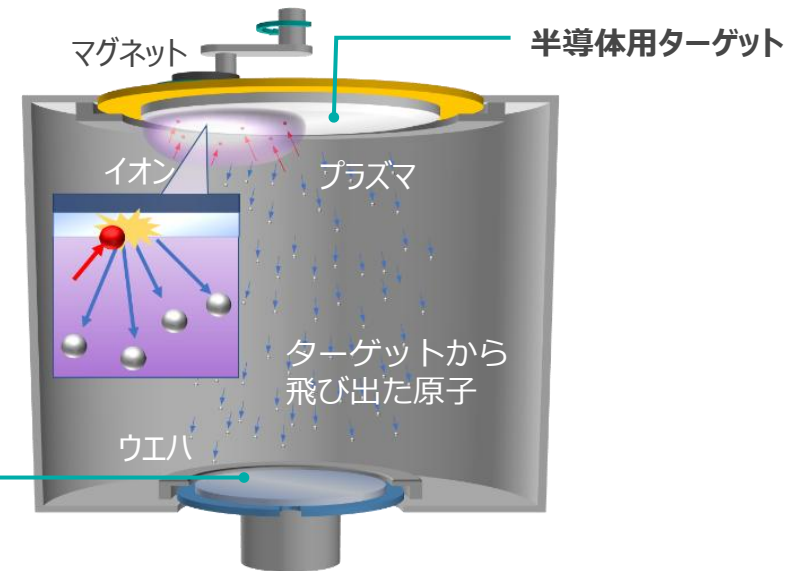
シリコンウエハ上にトランジスタや配線層を形成するためのPVD*1工程で必要となる高純度の金属材料

半導体チップ製造における使用工程

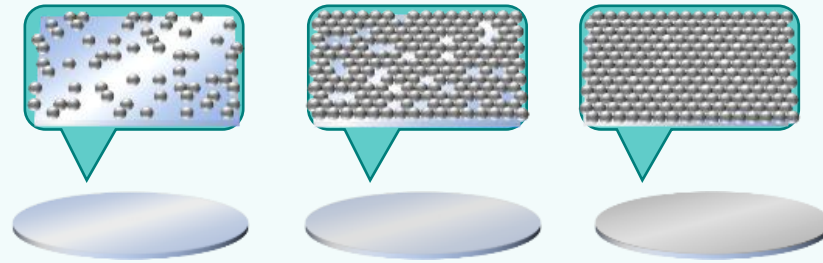


使用過程・構造

(スパッタチャンバー内部模式図)



スパッタリングプロセスで膜が形成される様子(模式図)



*1 Physical Vapor Deposition (物理気相成長法) の略。金属材料を気化させて基板に成膜する方法。スパッタリング法は代表的なPVDプロセスのひとつ

グローバルトップシェアを実現する当社半導体用ターゲットの強み

技術力の高さやメーカー・顧客との関係性、グローバルな生産体制を完備し、グローバルトップシェアを実現

世界トップクラスの 技術力

高純度化、組成・組織制御、
表面処理、分析評価などで高い
技術力を保有



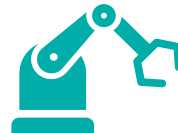
世界最高レベルの
高純度銅
純度
99.99999999%

半導体製造装置メーカー との強固な関係

装置メーカーとの関係構築を通じて
装置の標準材料への指定を獲得



J X 金属



装置メーカー

顧客(半導体メーカー) との信頼関係

長年にわたる取引実績を有し
優秀なサプライヤーとして表彰獲得



TSMC



Intel



SK hynix

グローバルな生産体制

半導体メーカーの生産拠点との
地理的優位性のある拠点を保有

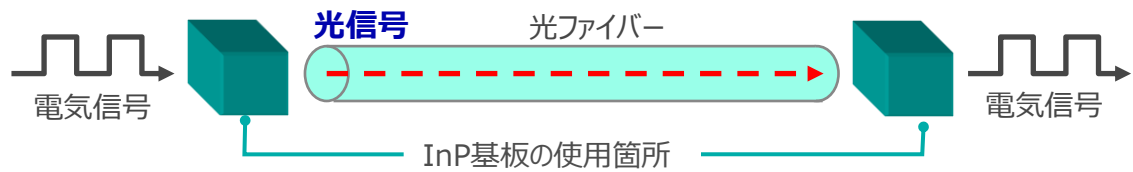


InP基板について

- 光通信用途で使用するインジウムリン（InP）基板は、**データセンター向けで販売好調**
- 急速な市場の拡大を捕捉すべく、**更なる増産に向けた設備投資を決定**
- 今後**データセンター内通信の光化の進展に伴い、更なる成長ポテンシャル**も期待

InP基板とは

- 電気信号と光信号の変換を行う光通信用途として、データセンター・インターネット網に使用される材料
- InPは光トランシーバーの受光素子・発光素子に使用される

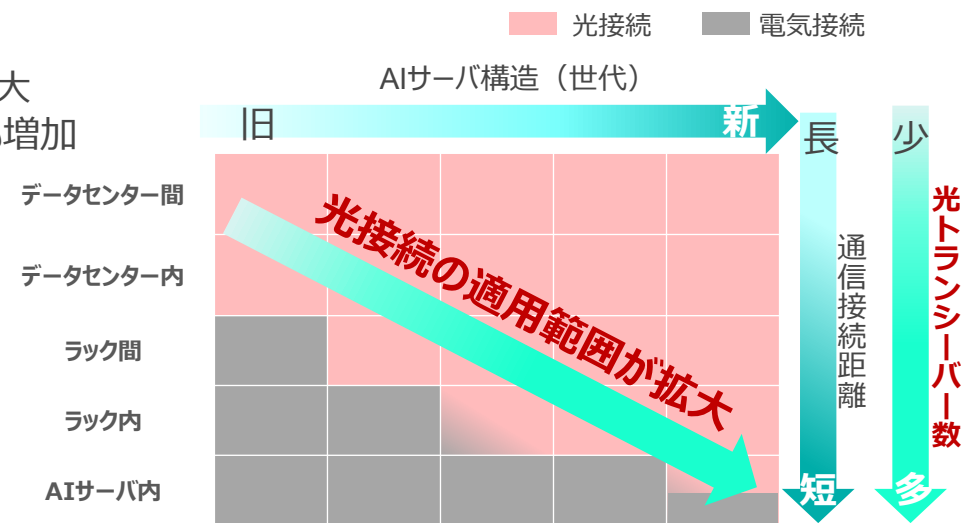
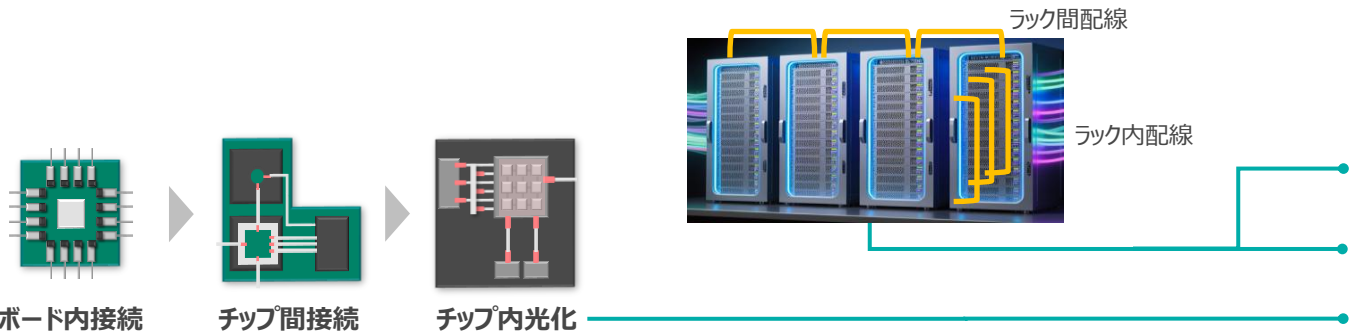


InP収益規模拡大に向けた取り組み

リリース	生産能力 - 2025年度比	投資額
2025年7月	2 割増	約15億円
2025年10月	約 5 割増	約33億円
2026年2月	約 3 倍（27年度以降順次稼働予定）	約200億円
2026年6月	7~10倍	最大 1,200億円

電気から光へのシフトに伴う成長機会

- 高速通信化・データセンター内の消費電力増加に伴い、近距離向けにも光通信の適用が拡大
- 光通信の適用範囲拡大に伴いトランシーバー使用量が増えることで、当社InP基板の需要も増加



ベース事業の取り組み

長期ビジョンに沿ったフォーカス事業中心のポートフォリオに向けて、ベース事業の最適な体制を構築

ベース事業における主な取り組み：事業規模の適正化、フォーカス事業のサプライチェーン確保を着実に実行

	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	
資源事業 ベースメタルから レアメタルへ	Mibra鉱山(タ ンタル)投資	カセロネス銅 鉱山およびロ ス・ペランブ レス銅鉱山権 益の一部売却	カセロネス銅 鉱山権益の追 加売却	Copi PJ(レアメタル・レアア ース)参入・丸紅の開発調 査への参加	カセロネス銅鉱山の一部権益・ フロンテラ地域における銅鉱山 開発プロジェクト権益譲渡 Fireweed社(レアメタル等)株式取得 (2026年4月クロージング)
金属・ リサイクル 事業 リサイクル中心の より効率的な体制へ	韓国の銅製錬 JVのLS- Nikko全持分 売却	パンパシフィ ック・カッパ ー株式の一部 譲渡	製錬・リサイ クル事業の高 付加価値化 (三菱商事と の協業)	パンパシフィック・カッパー (JX金属・三井金属・丸紅)と 三菱マテリアルの銅精鉱の購 入・電気銅等の販売に係る事 業の統合	
	eCycleの株 式取得(双 日との協業)			➤ 最終契約書締結(2026年5月) 出資比率： JX金属32.50%、三菱マテリアル32.00%、 三井金属21.90%、丸紅13.60%	

中長期事業目標

✓ 目標達成に向け、着実に進捗中

		2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	(参考)	2027年度
		実績	実績	実績	見通し	CAGR (2023年度-2026年度)	目標
営業利益	[連結]	862 億円	1,125 億円	1,750 億円	2,320 億円	(39%)	CAGR10%~15% (2023年度-2027年度)
	(YoY成長率)		30.5%	55.6%	32.6%		
	[フォーカス事業]	273 億円	518 億円	710 億円	1,000 億円	(54%)	CAGR35%~40% (2023年度-2027年度)
	(YoY成長率)		89.7%	37.1%	40.8%		
営業利益率	[連結]	5.7%	15.7%	19.8%	22.6%		12%~17%
	[フォーカス事業]	8.8%	12.5%	14.3%	17.1%		15%~20%
	[半導体材料セグメント]	21.4%	18.0%	22.3%	26.5%		25%~30%
	[情報通信材料セグメント]	0.5%	9.5%	9.9%	11.0%		8%~13%
営業利益構成比率	[フォーカス事業]	26%	41%	34%	40%		67%以上
	[半導体材料セグメント]	25%	21%	19%	25%		45%以上
ROE		18.3%	11.0%	15.6%	19.8%		10%以上
NET Debt/EBITDA倍率		2.6倍	1.6倍	1.2倍	1.5倍		1.5倍未満

本資料に記載されている当社の目標、計画、見積もり、予測、予想、ターゲットその他の将来情報については、本資料の作成時点において、当社が入手できる情報をもとに、一定の前提に基づく当社の判断又は考えに過ぎず、実際の当社の経営成績、財政状態その他の結果は、国内外の経済情勢・市場環境、事業活動、他社との競争環境その他様々な要因等により、本資料の内容又は本資料から推測される内容と大きく異なることがあります。

